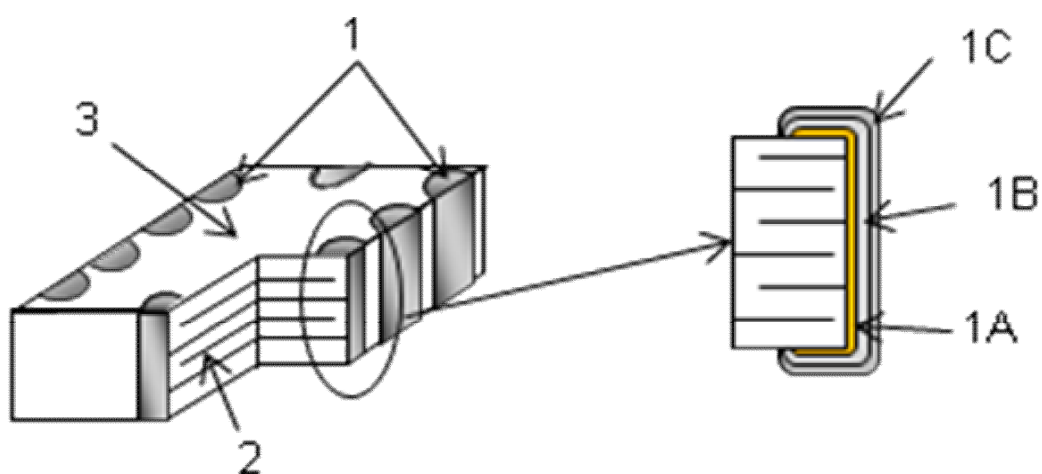


低 ESL 型チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表
 Structure and Material of Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<LLM Series>



| No. | 名称(Name) | 材料(Material) |
|-----|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 外部電極 (Termination) | 1A 銅(Cu) |
| | | 1B ニッケルめっき(Ni plated) |
| | | 1C すずめっき(Sn plated) |
| 2 | 内部電極(Inner electrode) | ニッケル(Ni) |
| 3 | 誘電体素子(Dielectric layer) | チタン酸バリウム(BaTiO ₃) |